



平成26年京大桂ベンチャープラザは開設10周年を迎えます
記念企画 連続技術セミナー

無電解めっきの基礎と最新動向

2014
10/17 (金)
16:00-18:00

参加費

無 料

定員30名

※先着順

場所：京大桂ベンチャープラザ南館

講師：甲南大学名誉教授 縄舟秀美先生

【概要】

無電解めっきは、プラスチックやセラミックスのような素材にも各種金属皮膜を形成できる。また、電気めっきと異なり電流分布の影響がないので、複雑な形状の部品に対しても均一な膜厚のめっきができることが最大の特徴である。

これらの特徴を活用して、各種プリント配線板の製造、半導体パンプ接合、電子部品のはんだ接合・ワイヤーボンディングを目的とした皮膜形成に各種無電解めっきが適用されるようになってきた。無電解めっき技術は、更なる機能化が要求される情報家電、自動車、燃料電池・医療福祉機器などの製造において用途展開が期待されている。

本講では、無電解めっきの特徴、基礎知識、および高度独自技術の確立に繋がる開発動向について最新事例を含め紹介する。

主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部 京大桂ベンチャープラザ

共催：京都府鍍金工業組合、鍍秀会

後援：京都市イノベーションセンター、京都桂産学コミュニティコア

参加申込書

送信先 E-mail : kkvp-info@wm.smrj.go.jp F A X : 075-382-1072

京大桂ベンチャープラザ宛 申込締切：10月15日（水）

フリガナ お名前		
企業名・団体名		
住所	〒	
所属・役職		
E-mailアドレス		
電話番号/FAX番号	TEL	FAX

※個人情報につきましては、本セミナーの実施・運営以外の目的で利用することはありません。

ウェブサイト <http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/index.html> からもお申込みいただけます。

京大桂ベンチャープラザへのアクセス

※ご来館は公共交通機関をご利用ください

阪急京都線 桂駅西口からバス12分

(京都市バス 西6系統, 京阪京都交通 20系統)

桂イノベーションパーク前下車 徒歩1分

JR東海道線 桂川駅からバス15分

(ヤサカバス 6号系統)

桂イノベーションパーク前下車 徒歩1分



お問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部
 京大桂ベンチャープラザ
 〒615-8245 京都市西京区御陵大原1-36
 TEL 075-382-1062 FAX 075-382-1072
 E-mail: kkvp-info@wm.smrj.go.jp

入居者募集中

最新の公募情報はホームページでご確認ください

京大桂ベンチャープラザ

検索